

產品名稱

SFENG 1984 產品名稱 ()

產品規格

PCB ICT FCT ()

2 ()

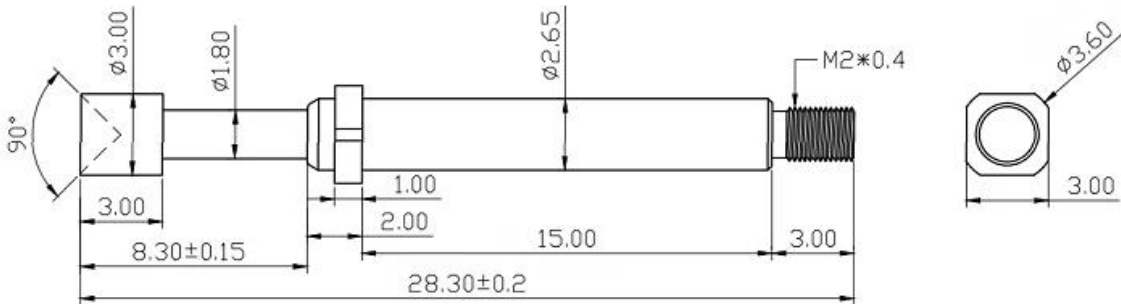
BGA ()

QZ VZ LM

;

/ ;

30#OK POM



Materials(Plated) (材質與鍍層) :

Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated
 Plunger(針軸) : Becu(鍍銅) , Au on Ni Plated
 Spring(彈弓) : SWP (琴鋼線) , Au on Ni Plated

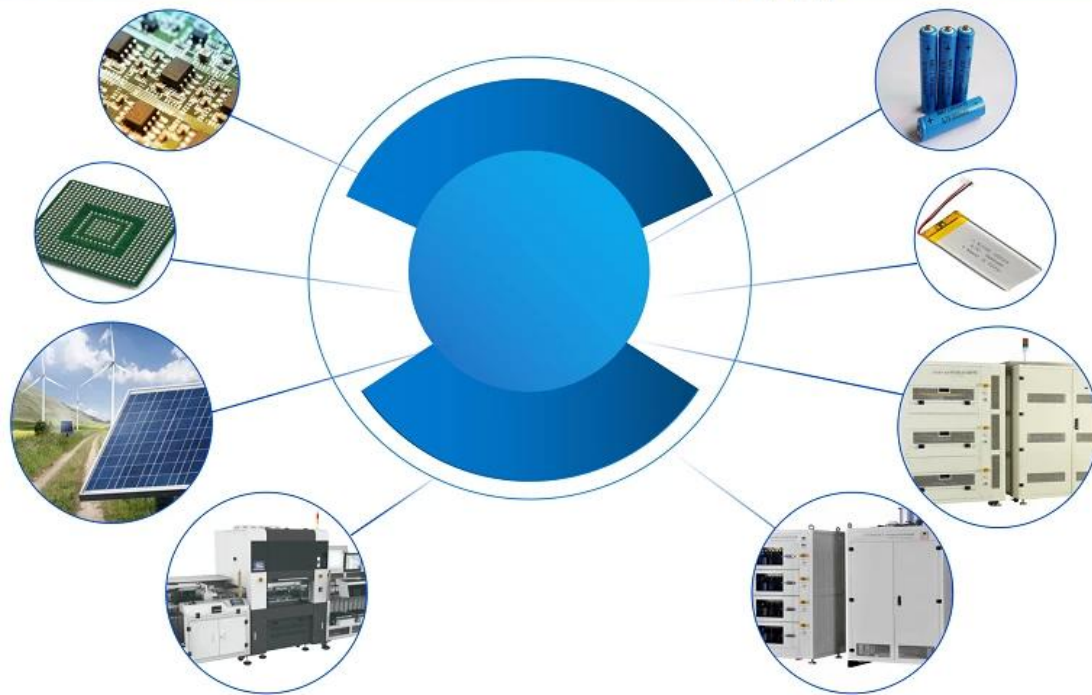
Specifications (技術要求) :

Current Rating(額定電流) : 5A
 Contact Resistance(接觸電阻) : ≤50mΩ
 Full Stroke(滿沖程) : 5.30mm
 Rated Stroke(額定沖程) : 4.0mm
 Spring Force(額定彈力) : 150±25gf@ load 4.0mm

產品規格

產品名稱	SF-113-303-300-A-1502M
產品規格	
產品材料	Au
產品電流	3A
產品彈力	
產品長度	7±10

[illegible]



000000



問 題 集

Q1. 品質管理とは何ですか？

A1: 品質管理とは、製品の品質を一定の水準に保つための活動です。

Q2. 品質管理の重要性は何ですか？

A2: 品質管理は、QC (品質管理) の活動であり、製品の品質を一定の水準に保つための活動です。品質管理は、製品の品質を一定の水準に保つための活動です。

Q3. 品質管理の目的は何ですか？

A3: 品質管理の目的は、製品の品質を一定の水準に保つことです。

Q4. 品質管理の手法は何ですか？

A4: 品質管理の手法は、品質管理の手法であり、製品の品質を一定の水準に保つための活動です。

Q5. 品質管理の手法は何ですか？

A5: 品質管理の手法は、品質管理の手法であり、製品の品質を一定の水準に保つための活動です。

Q6. 品質管理の手法は何ですか？

A6: 品質管理の手法は、品質管理の手法であり、製品の品質を一定の水準に保つための活動です。

Q7. OEMとODMの違いは何ですか？

A7: OEM (Original Equipment Manufacturer) と ODM (Original Design Manufacturer) の違いは、製品の設計と製造の責任の所在です。

Q8. 品質管理の手法は何ですか？

A8: T/T (Telegraphic Transfer) と L/C (Letter of Credit) は、品質管理の手法であり、製品の品質を一定の水準に保つための活動です。

問 題 集

品質管理の手法は、DHL、UPS、FedEx、TNT、EMS などの物流会社を利用することです。

品質管理の手法は、Exwork、FOB、CNF、CIF などの貿易条件を利用することです。





2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe

□□□□□□□□:







000000



CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

